

開示の要約

研磨装置および研磨方法

- 5 半導体デバイスの製造に使用されるワークピースの膜厚をワークピースの研磨中に正確に測定することができる研磨装置および研磨方法が開示される。処理システムは、以下の算定式により算定された相対反射率データに基づいてワークピースの膜厚を決定するように構成されている。相対反射率データ = $MD\ 1 / [BD\ 1 \cdot k]$ 。ここで、MD 1 は第 1 分光器によって測定されたワークピースからの反射光
- 10 の強度を示す第 1 強度測定データであり、BD 1 は第 1 ベース強度データであり、k はワークピースの研磨中に第 2 分光器によって測定された光源の光の強度を示す第 2 強度測定データの、第 2 ベース強度データに対する変化率である。

図 2

15